北京迈芯维LED小间距GOB技术难点简述

产品名称	北京迈芯维LED小间距GOB技术难点简述
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

GOB封装材料配制是难题，原材料必须符合下列规定：1.附着力强2.抗拉力和竖直撞击力强3.强度4.高清晰度5 耐热性6.耐黄变7.耐盐雾8.高耐磨性能

GOB封装材料要彻底添充LED灯珠空隙并遮盖LED灯珠表层，不要出现汽泡、出气孔、裂缝未填充斥着的情况

胶层厚度一致性要一致（LED灯珠表层之上胶层厚度一致），若没有达到一致也会产生死机、照亮状态下模块化设计、屏幕闪烁、拼凑多少不高低不平的致命弱点

GOB封装形式表层处理，针对不同应用场景分哑面、磨砂、镜面玻璃

GOB封装形式后维修性，要确保封装材料在特定前提下常与除掉，检修之后对除掉内容进行添充修复